



OMB No. 0651-0011 (exp. 4/94)

* Document ID No. 1013551

101501591

BUCKET NO.
849 Hoshino

To the Honorable Commissioner of Patents and Trademarks: Please record the attached original documents or copy thereof

1. Name of conveying party(ies):
Nemic-Lambda K.K.
Additional name(s) of conveying party(ies) attached? yes no

2. Name and address of receiving party(ies)
Name: **Densei Lambda K.K.**
Internal Address:
**Denpa Building, 1-11-15, Higashi, Gotanda,
Shinagawa-ku, Tokyo, JAPAN**

3. Nature of conveyance:
 Assignment Merger
 Security Agreement Change of Name
 Other _____
Execution Date: _____

Street Address: Same as Above
City: _____ State: _____ Zip: _____
Additional name(s) & address(es) attached?: yes no

4. Application Number(s) or Patent Number(s): **4,787,020**
If this document is being filed together with a new application, the execution date of the application is : _____
A. Patent Application No.(s)
B. Patent No.(s) **4,787,020**
Additional numbers attached? yes no


6. Total number of applications and patents involved:

5. Name and address of party to whom correspondence concerning document should be mailed:
Name: **Burgess, Ryan & Wayne**
Internal Address: _____
Street Address: **370 Lexington Avenue**
Suite 2105
City: **New York** State: **NY** Zip: **10017**

7. Total fee (37 CFR 3.41).....\$40.00
 Enclosed **with Recordation Form and Letter dated April 21, 2000**
 Authorized to be charged to deposit account any additional fees and/or overpayments

8. Deposit account number:
02-4743
(Attach duplicate copy of this page if paying by deposit account)

DO NOT USE THIS SPACE

9. Statement and signature.
To the best of my knowledge and belief, the foregoing information is true and correct and any attached copy is a true copy of the original document.
Milton J. Wayne  **September 20, 2000**
Name of Person Signing Signature Date
Total number of pages including cover sheet, attachments, and document:

Mail documents to be recorded with required cover sheet information to:
Commissioner of Patents & Trademarks, Box Assignments
Washington, D.C. 20231

東京都品川区東五反田一丁目11番15号電波ビルディング
デンセイ・ラムダ株式会社

会社法人等番号 007904

商号	ネミック・ラムダ株式会社	
	デンセイ・ラムダ株式会社	平成11年10月 1日変更
		平成11年10月 1日登記
本店	東京都品川区西五反田六丁目25番11号福島ビル	
	東京都品川区東五反田一丁目11番15号電波ビルディング	昭和54年 7月 9日移転
公告をする方法	日本経済新聞に掲載する	
会社成立の年月日	昭和53年6月6日	
目的	<ol style="list-style-type: none"> 1. <u>電子機器およびその関連する電子・機械装置ならびにその周辺機器および部品の製造、販売および輸出入</u> 2. <u>前号記載の装置・製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権および技術的知識（ノウ・ハウ）の開発および実施許諾</u> 3. <u>前各号に関連または付帯する一切の業務</u> 	
	<ol style="list-style-type: none"> 1 コンピュータ機器、通信機器等の電子機器およびその関連する電子・機械装置ならびにその周辺機器および部品の製造、販売および輸出入 2 発電装置、電源装置、充電装置等の電気機械器具の製造、販売および輸出入 3 医療機械器具、精密機械器具、工業用計測機器の製造、販売および輸出入 4 バーコード読取装置、機器等の情報機械器具の製造、販売および輸出入 5 前各号記載の装置・製品に関する特許権、実用新案権、意匠権、商標権および技術的知識（ノウ・ハウ）の開発および実施許諾 6 電気工事の設計および請負 7 電気通信工事の設計および請負 8 発電装置に関する建設工事の設計および請負 9 機械器具設置工事の設計および請負 10 前各号に関連または付帯する一切の業務 <p style="text-align: right;">平成11年 6月25日変更 平成11年 7月14日登記</p>	
額面株式1株の金額	金50円	
一単位の株式の数	100株	
発行する株式の総数	5000万株	

整理番号 ス208251

* 下線のあるものは抹消事項であることを示す。

1/9

TRANSLATION OF REGISTER

Trade Mark: DENSEI-LAMBDA K.K.

Main Office: Denpa Building, 1-11-15, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan

Corporation No. 007904

Trade Mark:	<u>NEMIC-LAMBDA K.K.</u>	
	DENSEI-LAMBDA K.K.	Date of Change : October 1, 1999
	Date of Registration: October 1, 1999	
Main Office:	<u>Fukushima Building, 6-25-11, Nishi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan</u>	
	Denpa Building, 1-11-15, Higashi Gotanda, Shinagawa-ku, Tokyo, Japan	Date of transfer:
	July 9, 1979	
Method for Announcing the Change:	Published in the Nippon Keizai shinbun	
Date of Foundation of the Company:	June 6, 1978	

DECLARATION

I, Akira Hoshino, having my residence in 35-8, Akabane-nishi 1-chome, Kita-ku, Tokyo, Japan, do solemnly and sincerely declare that I well understand the English and Japanese languages and that the attached English translation is a correct, true and faithful translation of the attached Japanese document to the best of my knowledge.

Tokyo, August 25, 2000

A handwritten signature in cursive script, reading "Akira Hoshino".

Akira Hoshino